

embedded world 2026 の 会場レポート

- The global platform for the
embedded community -



製品分野	展示ホール	出展者数	来場者数
組込みシステム、半導体、IoT、AI、ソフトウェア開発ツール、セキュリティなど	7つのホール： 1、2、3、3A、4、4A、5	2026年 1,262社 (43カ国) 2025年 1,188社	2026年 約36,000人 (90カ国) 2025年 31,783人

2026年3月10日(火)～12日(木)の3日間、ドイツ・ニュルンベルクメッセにて、組込みシステム分野における世界最大級の専門見本市「embedded world Exhibition & Conference 2026」が開催されました。

会場には世界43カ国から1,262社の企業が出展し、半導体メーカー、ソフトウェア企業、電子部品メーカー、開発ツールベンダー、スタートアップなどが最先端の組込み技術を紹介しました。出展企業数は前年比で6%増と高い水準となり、組込みシステム分野への関心の高さがうかがえました。

また、約90カ国から約36,000人の来場者が訪れ、前年比13%以上の増加を記録し、展示会の力強い成長を示しました。



● embedded world とは

embedded world は、組込みシステム分野に特化した世界最大級の専門展示会です。半導体、組込みソフトウェア、開発ツール、IoT、AI、セキュリティなど、組込みシステムを構成する幅広い技術が一堂に集まり、世界中のエンジニアや企業が最新技術や開発動向を共有する場となっています。

会場では製品の内部を支える技術や開発ツールなど、実際の製品開発に直結する技術が数多く紹介されており、組込み分野の技術者や企業が集う国際的なイベントとして知られています。

最新の組み込み技術トレンドが集結した展示会

会場には AI、半導体、IoT、車載システムなど組み込み分野の最新技術トレンドが集結していました。以下、今年の embedded world で感じたトレンドを簡単に紹介していきます。

● 半導体メーカーの存在感

世界の主要半導体メーカーが大型ブースを構え、マイクロコントローラや車載半導体など組み込み技術の中核分野を紹介していました。欧州の3大メーカー、NXP、インフィニオン、ST マイクロエレクトロニクスをはじめ、日本のルネサスエレクトロニクスと米国の半導体メーカーが一堂に会し、会場はまるで半導体の展示会のような様相を呈していました。



NXP



ST マイクロエレクトロニクス



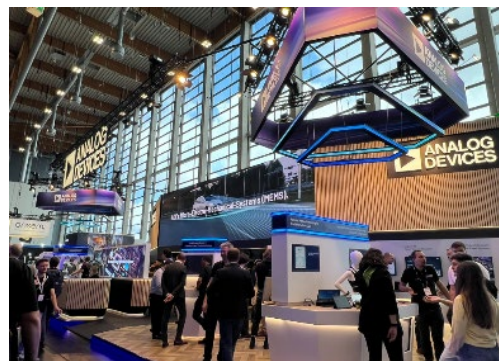
インフィニオン



ルネサスエレクトロニクス



Intel



ANALOG DEVICES

- **AI / Edge AI**

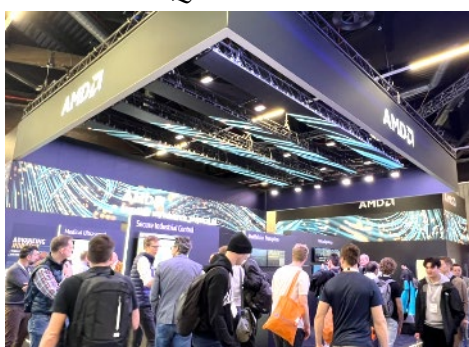
AI 関連の展示が大きく増え、Texas Instruments、Qualcomm、AMD をはじめ、AI 処理をデバイス側で行う「Edge AI」に関連する低消費電力デバイスから高性能処理まで幅広いソリューションを多く紹介していました。組み込み分野でも AI 技術の活用が急速に広がっていることが感じられました。



Qualcomm



Texas Instruments



AMD



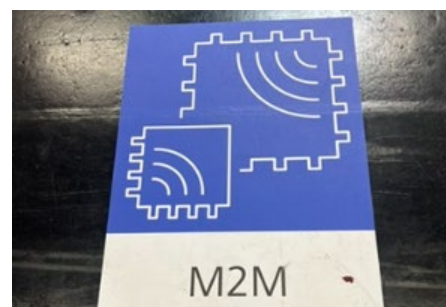
MEDIATEK

- **RISC-V アーキテクチャ**

オープンアーキテクチャである RISC-V への関心も高く、プロセッサや開発ツールの展示も多く見られ実用化フェーズへの移行が進んでいる様子がうかがえました。

- **組み込みソフトウェア・開発ツール**

機器の機能をソフトウェアで制御・更新する技術の広がり背景下、組み込みソフトウェアや開発ツール関連の展示も多く見られたことも今年の特徴です。



- **IoT / M2M (Machine-to-Machine)**

センサーや通信モジュールを活用した IoT・M2M 関連のソリューションも多く、特に産業用機器、スマートシステムへの応用を想定した展示が数多く並びました。

- **組込みセキュリティ**

IoT 機器の普及を背景に、デバイス認証など組込み機器のセキュリティ関連技術の展示も増える傾向にありました。



- **ディスプレイ / HMI (Human Machine Interface)**

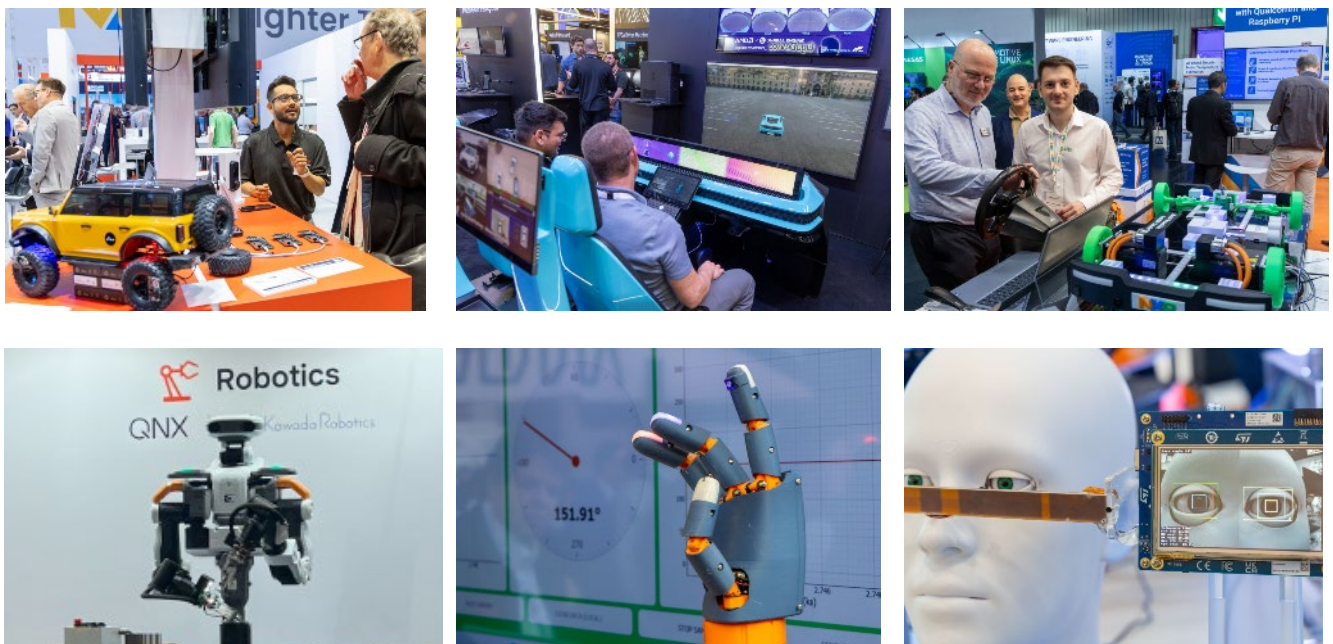
タッチパネルや GUI など、組込み機器の操作や表示に関わるユーザーインターフェース技術の展示も多く見られました。

- **自動車・モビリティ分野**

欧州の強い自動車産業を背景に、車載用マイクロコントローラやセンサー、パワー半導体など、自動車向けソリューションを紹介する展示が数多く見られました。また、車両の電子化やソフトウェア化が進む中で、自動運転や運転支援システム、電動化に関連する技術も紹介されており、組込みシステムが自動車産業の重要な基盤技術となっていることが感じられました。

- **製造業・産業用途**

産業機器やスマートファクトリー向けの組込み技術など、製造業分野での活用、デジタル化を支える技術として非常に注目され、展示も目立ちました。



● 日本企業の出展

今回の展示会には日本企業も 20 社以上が出展し、半導体のルネサスエレクトロニクスやソシオネクスト、電子部品分野ではパナソニック、村田製作所、TDK、組み込みソフトウェア分野では eSOL、半導体設計サービスでは TOPPAN など、幅広い分野で独自の技術を紹介し、多くの来場者の関心を集めていました。

特にマイクロコントローラ分野で世界的なシェアを持つルネサスエレクトロニクスのブースには多くの来場者が集まり、注目度の高さがうかがえました。

日本の出展企業からは「来場者は技術者や開発者が多く専門性が高い」「自動車、産業機器、通信など幅広い分野の企業が来場している」「新たな分野の開拓と共に技術トレンドを知ることができる」といった声が聞かれました。

主な日系企業（22 社）

Anritsu EMEA GmbH / CATANA Corporation / Circuit Design, Inc. / eSOLCo., Ltd. / Epson Europe Electronics GmbH / HAGIWARA Solutions Co., Ltd. / HIROSE ELECTRIC EUROPE B.V. / Hitachi America, Ltd. / KIOXIA Europe GmbH / Kowa OptimedDeutschland GmbH / KYOCERA AVX Components Ltd. / Murata Electronics Europe B.V. / Nisshinbo Micro Devices Inc. / Panasonic Industry Europe GmbH / Renesas Electronics / Socionext Europe GmbH / Sony SemiconIL / SUMIDA flexible connections GmbH / TDK Corporation / TOPPAN INC. / TorexSemiconductor Europe Ltd. / Yamaichi Electronics Deutschland GmbH



欧州企業と日本企業

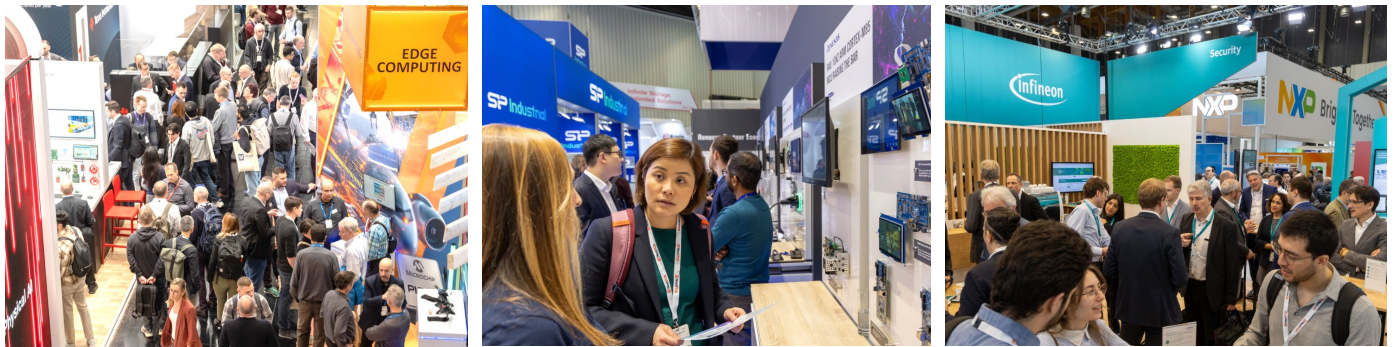
欧州・米国企業では、半導体やプロセッサ、開発プラットフォームなど、システムの中核となる技術を提供する企業の存在感が大きく、組み込みシステム全体のアーキテクチャを支える役割を担っているように感じられました。

一方、日本企業は電子部品やセンサー、マイクロコントローラなど、機器の性能や信頼性を支える要素技術の分野で強みを発揮している印象がありました。

こうした企業が同じ展示会で技術を紹介することで、組み込みシステムを構成する多様な技術分野が集まり、産業全体のエコシステムを俯瞰できる点も **embedded world** の特徴と言えるでしょう。

技術者中心の専門展示会 - **embedded world** -

embedded world は、組み込みシステム分野の最新技術を一堂に見ることができる世界有数の専門展示会です。多くの IT 関連イベントがビジネス向けの展示会となる中でも、本展示会は実際の製品開発に携わるエンジニアや技術者が中心となる点が特徴で、会場では半導体や電子部品、開発ツールなど製品の内部を支える技術が数多く紹介されていました。



また、**embedded world** は世界中の組み込みシステムのエンジニアや企業が集まるコミュニティの場としての役割も果たしており、技術交流や情報共有の重要なプラットフォームとなっています。今回、ブースは活気に満ち溢れ、通路は人でごった返し、活発な議論が交わされ、多様なアイデアが飛びかかっていました。

組み込みシステムは自動車、産業機器、IoT など多くの分野を支える基盤技術であり、**embedded world** はその最新動向を知ることができる重要なイベントとなっています。

次回開催

embedded world 2027

開催予定：2027年3月16日-18日

会場：ドイツ・ニュルンベルクメッセ